12주 1강. 광섬유의 연결, 광통신 링크 설계



Where are we?



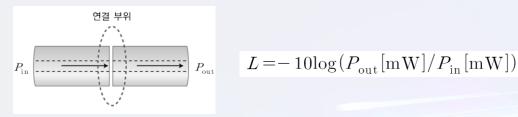


- ▶ 기본 요소들을 이용하여 광통신 시스템을 구성할 때 알아야 할 사항
 - 광섬유를 연결하는 방법
 - 광통신 링크를 설계할 때 일반적으로 적용하는 설계 지침 (design guideline)

- □ 발광소자(LED, LD)와 광섬유, 광섬유와 수광소자(광다이오드)와 결합하는 기본적인 3가지 방법
- ▶ 직접 결합
- ▶ 렌즈 결합
- ▶ 광섬유의 끝부분을 렌즈 모양으로 변형하여 결합
- □ 광섬유끼리 연결하는 방법
- ➤ 접속(splicing)
- ➤ 커넥터(connector)

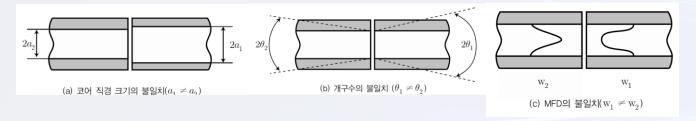
"광부품 업체는 패키지할 때 접속용 광섬유(pigtail)를 사용하기 때문에, 사용자는 단순히 광섬유끼리 어떻게 연결할지 만을 고려하면 된다"

- ◆ 연결 손실
 - 신호가 연결 부위를 통과하면서 전력 일부가 손실

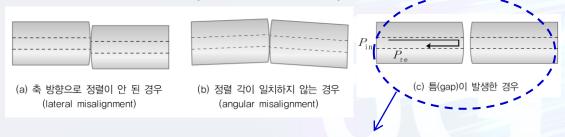


- 연결 손실의 원인
 - 내인성 손실(intrinsic loss)
 - 연결된 두 광섬유의 특성이 서로 달라서(mismatch) 발생하는 손실
 - 외인성 손실(extrinsic loss)
 - 연결 방법이 불완전하여 발생하는 손실
 - 주로 두 광섬유를 제대로 정렬하지 못했을 때(misalignment)
 발생하며, 이론적으로는 완전히 제거 가능

내인성 손실(intrinsic loss)



외인성 손실(extrinsic loss)



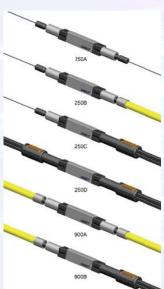
• 섬유 사이에 틈이 있으면 공기와 광섬유의 굴절 률 차이로 반사 손실(reflection loss)이 발생

- ◆ 접속(splicing)
 - 두 광섬유를 반영구적 또는 영구적으로 결합하는 것을 말하며,
 주로 실외에서 사용
 - 융착 접속(fusion splicing)
 - 두 광섬유를 일렬로 정렬시킨 후, 두 광섬유의 끝 부분에 열을 가해 녹여 하나로 결합하는 접속 방법
 - 연결 손실은 0.01dB에서 0.15dB 이하로 매우 낮은 편

- 기계식 접속(mechanical splicing)
 - 특수하게 제작된 구조물에 광섬유를 넣고 조여서 광섬유끼리 밀착해서 결합하는 방식
 - 주로 끊어진 광섬유를 빨리 수리해야 할 때 사용
 - 연결 손실은 약 0.2dB로, 융착 접속에 의한 연결 손실보다 높음

기계식 접속의 외형



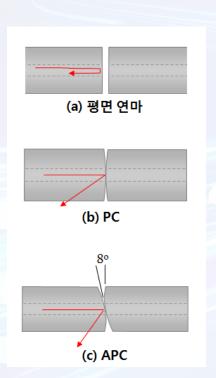


- ◆ 광커넥터(optical connector)
 - 두 광섬유를 연결하는 매우 중요한 소자로서, 접속과 달리 수시로 연결과 분리 가능
 - 흔한 오동작의 원인, 커넥터 작업에 많은 인력과 시간 필요
 - 기본 구조



- 연결 손실
 - 0.1dB에서 1dB 정도이며, 약 0.25dB 정도가 일반적인 값
- 광커넥터의 연결 부위는 반사 잡음의 원인

- 표면 연마 방식에 따른 광커넥터의 구분
- ➤ 평면 연마(flat finished)
 - 광섬유 표면의 작은 요철도 광섬유 사이에 틈을 만들기 때문에 반사 전력이 증가
- ➤ PC (Physical Contact)
 - 광섬유 끝을 부드러운 곡선으로 연마
 - 반사 전력과 요철에 의한 틈이 줄어 듬
- ➤ APC (Angled Physical Contact)
 - 약 8° 정도의 경사로 끝부분을 연마
 - 8°의 경사는 단일모드 광섬유의 수광각을 벗어나므로, 반사 전력 크게 감소



- 광커넥터의 종류
 - 표준 광커넥터는 없음 🗪



- 어댑터
 - 여러 종류의 커넥터를 서로 연결하기 위한 소자

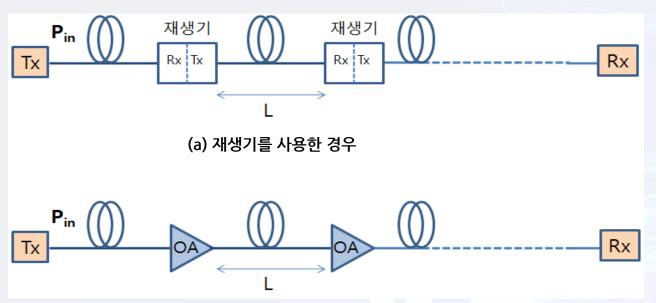


[주요 광커넥터의 특성(SM=단일모드, MM=다중모드)]			
커넥터	연결 손실	반복성	광섬유 종류
바이코닉(biconic)	0.6~1.0dB	0 <u>.</u> 2dB	SM, MM
D4	0.2~0.5dB	0,2dB	SM, MM
SMA	0,4~0,8dB	0,3dB	ММ
ST	Typ, 0,4dB(SM) Typ, 0,5dB(MM)	Typ. 0,4dB(SM) Typ. 0,2dB(MM)	SM, MM
SC SC	0,2~0,45dB	0.1dB	SM, MM
FC	0,5~1,0dB	0,2dB	SM, MM
LC	Typ. 0,15dB(SM) Typ. 0,10dB(MM)	0 <u>.</u> 2dB	SM, MM
FDDI	0,2~0,7dB	0,2dB	SM, MM

- ◆ 광통신 링크
 - 광통신 링크는 두 지점 사이의(point-to-point) 통신을 위해 광송신기와 광수신기를 광섬유로 연결한 형태
 - 광통신 시스템은 광통신 링크가 상호 연결된 네트워크로 발전
 - 광통신 링크의 손실 보상
 - 광섬유 길이가 20~100km 이상이면 광섬유의 손실 때문에 광수신기에 도달하는 광전력이 매우 낮음
 - 원하는 비트오율(BER)을 얻기 위해서는 손실을 보상해야 함
 - 손실을 보상하는 두 가지 방법
 - 재생기(regenerator) 사용
 - 광증폭기 사용

- 광통신 링크 설계
 - 중계기 간격 L
 - 재생기 또는 광증폭기 사이의 거리 L을 흔히 중계기 (repeater) 간격이라고 함
 - L이 길수록 광통신 링크의 전체 비용 절감
 - 광통신 링크는 광섬유의 손실뿐만 아니라 분산 특성에도 영향을 받으므로, L은 비트율 B에 의해 결정되기도 함
 - 광통신 링크의 성능을 나타내는 대표적인 지수로 BL곱을 흔히 사용
 - 중심 파장이 0.85μm인 제1세대 광통신 시스템은 BL곱이 ~1[(Gb/s)·km] 정도
 - 중심 파장이 1.55μm인 제3세대 광통신 시스템은 ~1[(Tb/s)·km] 정도





(b) 광증폭기를 사용한 경우

- ◆ 설계 지침(design guideline)
 - 중요한 설계 변수
 - 전송 거리
 - 전송 속도(즉, 비트율)
 - 동작 파장
 - 목표 비트오율(BER) 등
 - 광통신 시스템을 설계하기 위해서는 광송신기, 광수신기 및 광섬유의 특성을 명확하게 이해해야 함
 - 손실제한시스템(loss-limited system)
 - 수 km 이내의 짧은 거리를 제외하고는 광통신 링크를 설계할 때 가장 먼저 고려해야 할 사항은 광섬유의 손실 임

- ◆ 광통신 링크 설계
 - 광통신 링크를 설계할 때 전송 거리, 비트율, BER은 미 리 결정됨
 - 설계 지침은 광섬유의 종류와 동작 파장을 결정하는 출 발점이 된다.
 - 사용할 광섬유와 파장이 결정되면, 링크 설계(link budget) 단계를 거침
 - 전력 설계
 - 상승시간 설계
 - 전력 설계(power budget)
 - 광통신 링크의 예상 수명 동안 수신기에 수신 감도 P_{\min} 이상의 전력이 수신되도록 설계

➡ 설계 지침을 만족하면서 경제적으로 어느 방법이 가 장 유리한지 살펴보아야 함

- 상승시간 설계(rise-time budget)
 - 상승시간 설계는 목표 비트율에서 제대로 동작하도록 설계하는 것을 말함
 - 대역폭 설계(bandwidth budget)라고도 함
 - 광송신기, 광수신기의 상승시간은 광부품 회사의 기술 명세서에서 제공
 - 광섬유의 상승시간은 분산에 의한 펄스 퍼짐으로 계산.

